(12) 특허협력조약에 의하여 공개된 국제출원

(19) 세계지식재산권기구
국제사무국

(43) 국제공개일
2025 년 9 월 12 일 (12.09.2025)

WIPO | PCT

(10) 국제공개번호
WO 2025/187863 A1

(51) 국제특허분류:
B24B 37/22 (2012.01) *B24D 3/00* (2006.01)
B24B 37/24 (2012.01) *B24D 7/14* (2006.01)
B24D 3/32 (2006.01)

(21) 국제출원번호: PCT/KR2024/005945

(22) 국제출원일: 2024 년 5 월 2 일 (02.05.2024)

(25) 출원언어: 한국어

(26) 공개언어: 한국어

(30) 우선권정보:
10-2024-0032554 2024 년 3 월 7 일 (07.03.2024) KR

(71) 출원인: **케이피엑스케미칼 주식회사 (KPX CHEMICAL CO., LTD)** [KR/KR]; 04143 서울특별시 마포구 마포대로 137 (KR).

(72) 발명자: **민병주 (MIN, Byung Ju)**; 22734 인천광역시 서구 청라에메랄드로 156, 202동 2001호 (KR). **김승근 (KIM, Seung Geun)**; 18466 경기도 화성시 동탄순환대로26길 81, 458동 303호 (KR). **홍석지 (HONG, Seok Ji)**; 18444 경기도 화성시 동탄문화센터로 39, 319동 1501호 (KR). **하태종 (HA, Tae Jong)**; 05649 서울특별시 송파구 양재대로 1218, 204동 2304호 (KR). **이현희 (LEE, Hyun Hee)**; 44745 울산광역시 남구 중앙로47번길 27, 103동 1403호 (KR).

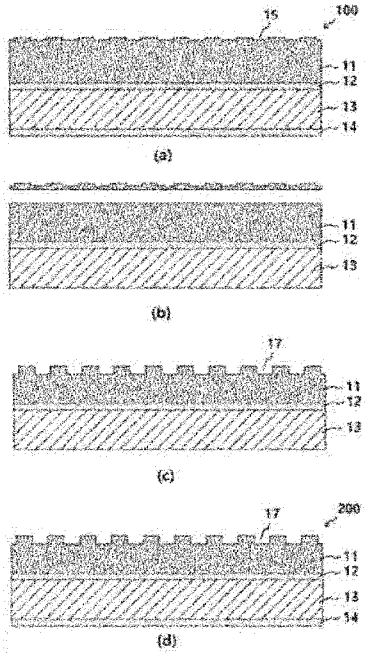
(74) 대리인: **김성호 (KIM, Sung Ho)**; 06221 서울특별시 강남구 언주로85길 24, 3층(역삼동, PNM 타워) (워너비특허법률사무소) (KR).

(81) 지정국 (별도의 표시가 없는 한, 가능한 모든 종류의 국내 권리의 보호를 위하여): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 지정국 (별도의 표시가 없는 한, 가능한 모든 종류의 역내 권리의 보호를 위하여): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), 유라시아 (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), 유럽 (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM,

(54) **Title:** POLISHING PAD

(54) **발명의 명칭:** 연마패드



(57) **Abstract:** The present invention provides a polishing pad comprising: an upper pad having grooves formed thereon; and a lower pad positioned below the upper pad, wherein the polishing pad has a value of Cp represented by formula 1 of 0.10 to 1.3.

(57) **요약서:** 본 발명은 그루브가 형성된 상층패드 및 상기 상층패드의 하부에 위치하는 하층패드를 구비하는 연마패드로서, 상기 연마패드는 식 1로 표시되는 Cp의 값이 0.10 내지 1.3인, 연마패드를 제공한다.

WO 2025/187863 A1

[다음 쪽 계속]

TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

공개:

— 국제조사보고서와 함께 (조약 제21조(3))